

2024深圳国际热管理材料技术展览会

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 2024深圳国际热管理材料技术展览会 |
| 公司名称 | 中展国际 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 |
| 联系电话 | 17620818513 |

产品详情

2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会

热管理材料技术专区

联系方式：请见右上方联系栏

时间：

2024年11月13-17日

地点：

深圳会展中心(福田)

创新驱动发展 智慧赋能未来

主办单位

商务部

科学技术部

工业和信息化部

国家发展改革委

农业农村部

国家知识产权局

中国科学院

中国工程院

深圳市人民政府

联合承办单位

中国机电产品进出口商会

科技部机关服务中心

工业和信息化部国际经济技术合作中心

全国农业科技成果转化服务中心

中国专利保护协会

中科院广州分院

中科院深圳先进技术研究院

国家信息中心

亚洲数据集团

中招国际会展(北京)有限公司

组织单位

广州fce展览服务有限公司

展览概述

随着电子技术的快速进步和更迭，芯片、器件以及电子设备等产品正向微型化、高性能化、集成化和多功能化方向发展。然而，功率密度和发热量也在急剧攀升。在双碳目标的背景下，电力电子、半导体、通信、新能源、汽车和绿色建筑等行业迫切需要实现节能环保。同时，消费电子、5G、人工智能、XR、数据中心、物联网、动力电池、储能、工业4.0、航空航天等领域的技术创新应用也在积极推动高效的热管理材料技术和创新的解决方案的发展，以确保终端产品的效率、可靠性、安全性、耐用性和持续稳定性。

为推动热管理产业集群高质量发展，2024高交会热管理材料技术专区展将于2024年11月13-17日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第二十六届中国国际高新技术成果交易会专区之一，专注于整合热管理产业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为热管理企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案，服务国家战略，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外热管理产业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向，直击产品热点、caigou对接。共享国际化大平台，共拓热管理材料技术及创新应用产业大市场，让我们携手同行，共创商机。

高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体。经过多年发展，高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口，有“中国科技展”之称，是中国乃至全世界颇具影响力的品牌展会。高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用。热管理材料技术专区作为高交会的重要组成部分，发挥高交会在国际科技交流合作和科技成果产业化等方面的积极作用，为全球热管理企业提供高品质、国际化、综合性的展览体验平台。将更深度探寻热管理产业高质量发展转型实施路径，更聚焦打造优化产业链供应链布局的交流合作，更直观展现热管理材料技术与时尚元素交融带来的感官冲击，更着力构建以科技创新和融合

创新为核心驱动的热管理产业生态圈，描绘未来热管理材料技术及创新应用科技给人们生活带来的无限可能。

高交会优势

品牌展会，国际平台：高交会是目前中国规模颇大、较具影响力的科技类展会，是中国乃至世界颇具影响力的品牌展会，是深圳市一张亮丽的名片。

厚重的历史沉淀，领导的殷切期望：高交会1999年至今已成功举办了25届，一直被誉为“中国科技展”，多位先后莅临高交会参观指导，出席历届高交会的有：朱镕基、吴邦国、吴仪、曾培炎、回良玉、汪洋、刘延东及多位全国人大、政协领导。

助力企业腾飞，跨国名企荟萃：高交会为众多企业带来良好收益。微软、IBM、索尼、高通、三星、惠普、西门子、东芝、甲骨文、LG、日立、松下、中国建筑等60多家跨国公司先后多次参展，腾讯、华为、金蝶、科大讯飞、大族激光、同洲电子等一大批中国民营企业从这里走向世界。

行业大咖云集，引领行业发展：透过大会举办的各种论坛、行业研讨会、互动分享会以及技术与产品发布会等活动，获得行业内新动向和发展趋势，参与技术交流，把握行业趋势。

海内外媒体关注，服务多元：每届展会有近200家海内外媒体的约1500多名记者参与报道。不仅包括中国媒体，也有来自海外的主流平面媒体及众多网络媒体。

蕴含商机，扩大商务交易：国际商务平台，全球买家、投资商云集，zhengfu、科研机构和商业汇聚，商机无限；即将投放市场的新兴科技产品、颠覆性技术，启迪新的创业方向、商业模式及投资机会。

展品范围

一、原材料

导热填料：氧化铝、氧化硅、氧化锌、氮化硼、氮化铝、氮化硅、碳化硅、氧化镁、氧化铍、石墨、炭黑等；铜粉、银粉、金粉、镍粉和铝粉等；

封装材料：铝、铜(镀铜)、钨/铜、钼/铜、硅/铝、铍/铝、泡沫金属/多孔金属等，氧化铝、氧化锆、碳化物、硼化物、氮化物、硅化物；橡胶；玻璃等；

聚合物材料：有机硅、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸树脂、聚酰亚胺、酚醛树脂等；

二、导/散热材料

热界面材料：导热硅胶、导热硅脂、导热凝胶、导热垫/碳纤维导热垫、聚合物基复合导热材料，液态金属，导热灌封胶等；

导热高分子：导热塑料(PPS、PA6/PA66、PC、PP、PPA、LDPE、PEEK)、导热绝缘塑料，导热橡胶等；

碳材料：石墨膜(PI膜)、金刚石、碳纳米管、碳纤维短纤、石墨烯导热膜等；

陶瓷基板：氧化铝(Al_2O_3)、氮化铝(AlN)、氮化硅(Si_3N_4)、氧化铍(BeO)；碳化硅(SiC)、氮化硼(BN)等；

热沉材料：金属/合金(半固态压铸件)；金刚石/铜、金刚石/铝等复合材料，石墨/铜、石墨/铝等复合材料，金属基复合材料；

相变材料(储热)：石蜡、脂肪醇、脂肪酸、烷烃基合金；熔盐、盐水合物、共晶混合物等；

隔热材料：气凝胶材料(碳基、二氧化硅、二氧化锆、氧化铝等)、碳毡、复合硅酸盐材料等；

固态制冷：热电制冷、辐射制冷等；

辅助材料：离型膜、双面胶等；

三、导/散热组件

热管/均热板，覆铜板，功率器件(碳化硅、氮化镓、氧化镓、MOSFET、IGBT)及模块等；

风扇，散热片，水冷板，热交换器，空预器，导热/散热模组等；

四、仪器/设备

分析测试仪器：热重分析、差热分析、差式扫描量热法、逸出气体检测和分析、热膨胀分析、动态热机械分析、热物性测量；黏度计、拉力机、密度计、硬度仪等；

点胶机；涂布/覆膜/压延/收卷，碳化/石墨化，模切；研磨，分散，均质，脱泡，灌装等；封装，焊接，压铸，真空注液等；

五、热设计：热仿真模拟/热设计软件等；

六、解决方案

热管理解决方案：空气冷却技术，液体冷却技术，3D打印等；

热分析：标准、检测、认证、对外测试服务平台(高校/科研院所)等；

七、创新技术：科研院所和企业研究院的实验室科研成果，企业新品，专利技术等；

八、终端应用

通信：5G、通信/移动基站、服务器、数据中心、云存储、电源、光通讯、射频、路由器/网关、WIFI；数据采集终端、传感器、雷达、物联网控制系统、物联网网关等；

消费电子：手机、平板、笔记本、台式机、VR/AR设备、智能手表、无人机、运动相机、游戏机、智能音箱、智能家电、可穿戴设备、打印机等；

工控电脑：加固型笔记本、工业平板、嵌入式电脑、商显电脑、工业控制计算机、显卡/网卡/硬盘等；

人工智能：机器人、智能终端、智能控制、无人驾驶、图传、语音交互、智能家居等；

医疗设备：治疗/检测仪器设备、监护设备、成像设备、移动医疗、便携式手持检查设备、DNA分析仪等；

智能安防：控制系统、监控系统、交通管理系统、应急指挥系统、智慧城市控制系统、网络摄像机等；

激光：LED/深紫外LED、激光照明、激光雷达、激光电视、激光投影、激光模块等；

电动汽车：电机及控制系统、动力电池、电池管理系统、车载电子设备、汽车雷达、充电桩等；

分析检测：物理/化学/生物等领域分析仪器；通讯测试设备、红外、光谱测试仪器、光通讯测试、电子检测、环境测试仪器、电源/控制/存储模块、ETC等；

其他：光伏、风机、储能与储热；功率电子、电力电子、柔性电子、军工电子；交通运输，汽车，航空航天等。

展会日程

报到布展：2024年11月11-12日

展出时间：2024年11月13-17日

撤展时间：2024年11月17日下午

欢迎业界同仁踊跃报名参展，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！充分利用
CHTF 2024，巩固您的市场地位！